

低温(220℃)硬化で、 その高い信頼性の要求を叶えます

At Only 220℃ curing, RD-100 make The High reliability come true!



半導体用感光性材料 RD-100 A01L

Photosensitive Dielectric material for Semiconductor

特長 Features

- **ポジ型液状タイプ**
Positive Liquid Type
- **高解像性** — アスペクト1以上の高い解像性を有しています —
High resolution — RD-100 A01L can form fine pattern —
- **高い信頼性** — 優れた薬品耐性とB-HAST耐性を有しています —
Good reliability. — RD-100 A01L show high chemical resistance and B-HAST resistance —

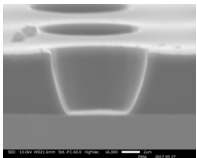
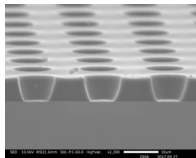
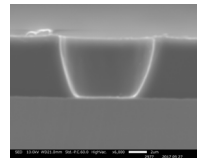
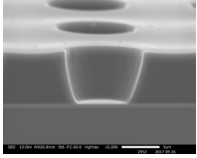
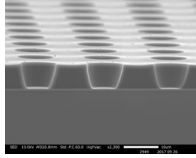
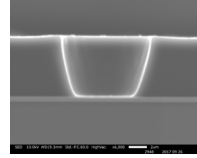
特性 Properties

パターニング条件(めっき Cu)

スピンコート : 2200rpm
 プリベーク : 110℃/3.5min
 露光 : 500mJ/cm(i-line)
 現像 : 35s /パドル(2.38%TMAH aq. 23℃)
 硬化 : 150℃/30min+220℃/60min(N2)

パターニング条件(スパッタ Cu)

スピンコート : 2200rpm
 プリベーク : 110℃/3.5min
 露光 : 500mJ/cm(i-line)
 現像 : 40s /パドル(2.38%TMAH aq. 23℃)
 硬化 : 150℃/30min+220℃/60min(N2)

Substrate	$\phi = 6\mu\text{m}$		Taper angle 70-80°
Plated Cu			
Sputtered Cu			

用途 Application

WLP再配線用絶縁膜(RDL)

